

# 深圳 PCB四层/6层电路板，四层线路板加急打样，（包测）

产品名称	深圳 PCB四层/6层电路板，四层线路板加急打样，（包测）
公司名称	深圳市永瑞泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：否:品牌：永瑞泰 型号：94HB - 94VO - 22F - CEM-1 - FR-4:机械 刚性：刚性 层数：多层:基材：铜
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道南5号303（办公场所）
联系电话	13824307674 13418488018

## 产品详情

### 产品图片

### 电路板介绍

印刷电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成，各组成部分的主要功能如下：焊盘：用于焊接元器件引脚的金属孔。过孔：用于连接各层之间元器件引脚的金属孔。安装孔：用于固定印刷电路板。导线：用于连接元器件引脚的电气网络铜膜。接插件：用于电路板之间连接的元器件。填充：用于地线网络的敷铜，可以有效的减小阻抗。电气边界：用于确定电路板的尺寸，所有电路板上的元器件都不能超过该边界。

### 材质介绍

按品牌质量级别从底到高划分如下：94hb - 94vo - 22f - cem-1 - cem-3 - fr-4详细参数及用途如下：94hb：普通纸板，不防火（最低档的材料，模冲孔，不能做电源板）94v0：阻燃纸板（模冲孔）22f：单面半玻纤板（模冲孔）cem-1：单面玻纤板（必须要电脑钻孔，不能模冲）cem-3：双面半玻纤板（除双面纸板外属于双面板最低端的材料，简单的双面板可以用这种料）

## fr-4: 双面玻纤板

阻燃特性的等级划分可以分为94vo - v-1 - v-2 - 94hb

四种半固化片：1080=0.0712mm，2116=0.1143mm，7628=0.1778mmfr4

cem-3都是表示板材的，fr4是玻璃纤维板，cem3是复合基板无卤素指的是不含有卤素（氟 溴 碘 等元素）的基材，因为溴在燃烧时会产生有毒的气体，环保要求。tg是玻璃转化温度，即熔点。电路板必须耐燃，在一定温度下不能燃烧，只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(tg点)，这个值关系到pcb板的尺寸耐久性。什么是高tg pcb线路板及使用高tg pcb的优点高tg印制电路板当温度升高到某一阈值时基板就会由“玻璃态”转变为“橡胶态”，此时的温度称为该板的玻璃化温度(tg)。也就是说，tg是基材保持刚性的最高温度( )。也就是说普通pcb基板材料在高温下，不断产生软化、变形、熔融等现象，同时还表现在机械、电气特性的急剧下降，这样子就影响到产品的使用寿命了，一般tg的板材为130 以上，高tg一般大于170 ，中等tg约大于150 ；通常tg 170 的pcb印制板，称作高tg印制板；基板的tg提高了，印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。tg值越高，板材的耐温度性能越好，尤其在无铅制程中，高tg应用比较多；高tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展，特别是以计算机为代表的电子产品，向着高功能化、高多层化发展，需要pcb基板材料的更高的耐热性作为前提。以smt、cmt为代表的高密度安装技术的出现和发展，使pcb在小孔径、精细线路化、薄型化方面，越来越离不开基板高耐热性的支持。所以一般的fr-4与高tg的区别：同在高温下，特别是在吸湿后受热下，其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异，高tg产品明显要好于普通的pcb基板材料。

### 生产能力及范围

产品广泛应于通讯、电脑、仪表、汽车、手机、mp4、dvd、lcd tv、led、usb、照明灯、仪器仪表、家用电器、控制器、汽车导航、机电设备等高科技电子领域，厂区占地面积约2000平方米，生产线拥有200名员工及技术工程人员，月产量达8000平方米。

单面、双面、多层、fpc、铝基板等。样板、小批量的快速生产.....

我司线路板生产工艺能力如下：

1、表面工艺：喷锡、无铅喷锡、镀镍/金、化学镍/金等、osp等.....

2、pcb层数layer 1-10层

3、最大加工面积 单面/双面板1200mmx450mm

4、板厚 0.2mm-3.2mm 最小线宽 0.10mm 最小线距 0.10mm

5、最小成品孔径 0.2mm 6、最小焊盘直径 0.6mm 7、金属化孔孔径公差pth hole dia.tolerance 0.8±0.05mm > 0.8 ±0.10mm 8、孔位差 ±0.05mm

9、绝缘电阻 > 10<sup>14</sup> （常态） 10、孔电阻 300 u

11、抗电强度 1.6kv/mm 12、抗剥强度 1.5v/mm 13、阻焊剂硬度 > 5h

14、热冲击 288 10sec 15、燃烧等级 94v-0 16、可焊性

235 3s在内湿润翘曲度t < 0.01mm/mm离子清洁度 < 1.56微克/cm<sup>2</sup>

17、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz 18、镀层厚度：一般为25um，也可达到36um

19、常用基材：fr-4、22f、cem-1、94vo、94hb 铝基板 fpc 20、客供资料方式：ger

ber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2007文件、autocad文件、orcad文件、pcbdoc文件、样板等  
[公司所在位置](#)

## 我所在位置（标题+图片）

### 联系方式

联系地址：广东省 深圳市 宝安区

联系电话：13418488018

传真号码：0755-27059167

腾讯qq：280295977

阿里旺旺：ad66688

本产品的加工定制：否是品牌：永瑞泰，型号：94HB - 94VO - 22F - CEM-1 - FR-4是机械刚性：刚性，层数：多层是基材：铜，绝缘材料：金属基是绝缘层厚度：常规板，阻燃特性：VO板是加工工艺：电解箔，增强材料：玻纤布基是绝缘树脂：环氧树脂(EP)，产品性质：热销是营销方式：厂家直销，营销价格：优惠